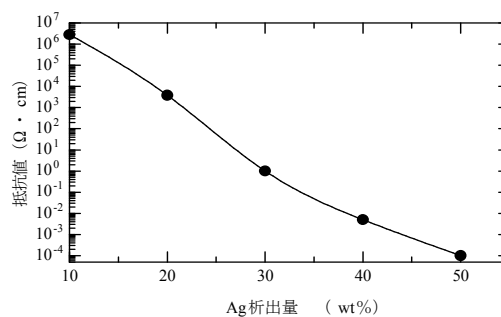
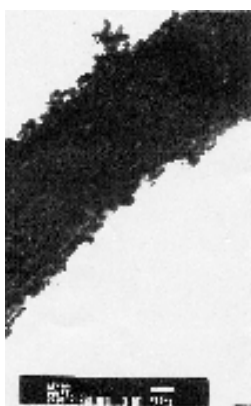


电磁波屏蔽、金属粘贴等多用途的陶瓷粒体的无电解 AG 电镀

1. 技术要旨

使各种粉体的金属化、导电性的方法、有干式、湿式等有多种建议。关于微粒子的金属覆盖也在探讨研究中。通过无电解电镀在粉体的金属覆盖，从 20 年前开始就有很多建议、到目前为止能提供只在产业上利用的量的制造厂家是相当少的。

本技术运用金属盐、还原剂、分散液所构成的电镀液，通过化学反应使各种微粉体被银覆盖，使其具有导电性。和以前的技术不同、析出金属的结晶状态均匀，增加了使用范围。



TiO₂+Ag パウダー TEM 像 × 10000 BaTiO₃+Ag パウダー TEM 像 × 50000 Ag 析出量抵抗値变化

2. 产品特点

- ① **低比重** 比金属粉体轻
- ② **复合材料的分散安定**
树脂成型、粘贴の場合、金属粉状体比重很大而沉淀，比重小的陶瓷粉状体通过金属覆盖处理，能形成散性良好的产品。
- ③ **导电性安定** 粘贴状态时，由于具有良好的分散性，导电性偏差少。
- ④ **低成本** 比金属粉状体成本更低。

3. 应用产品

通过应用本技术，让陶瓷粉状体（氧化铝，钛酸类）析出金属薄膜，用恰当的纸夹使之混合，作为含有铅的金属粘贴的代替材料，对要求具有导电性的产品，进行广泛地应用。另外处理粉体在树脂中分散，或处理粉状体在涂膜上，应用于能担负电磁波屏蔽作用的产品。关于上述技术，对陶瓷以外的粉状体也有业绩。

株式会社 友電舎
大阪市此花区常吉 2-4-8
Tel : 06-6465-1663 fax : 06-6468-5600
e-mail : ydn@pearl.ocn.co.jp
toiawase@ydn.co.jp
URL : <http://www.ydn.co.jp>